

证券代码：300776

证券简称：帝尔激光

武汉帝尔激光科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-005

投资者关系 活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☒其他 电话会议
参与单位名称	开源证券股份有限公司、广东正圆私募基金管理有限公司、招商证券股份有限公司、西部利得基金管理有限公司、同泰基金管理有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司、西部证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、上海申银万国证券研究所有限公司、国金证券股份有限公司、首创证券股份有限公司、上海榜样投资管理有限公司、财通证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、摩根士丹利投资有限公司、上海智尔投资有限公司、中国银河证券股份有限公司、朱雀基金管理有限公司、太平洋证券股份有限公司、摩根资产管理(亚太)有限公司、深圳市康曼德资本管理有限公司、华安证券股份有限公司、中国人寿资产管理有限公司、东方证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、信泰人寿保险股份有限公司、中信保诚基金管理有限公司、君义振华(北京)管理咨询有限公司、中信建投证券股份有限公司、瑞银集团、莫尼塔(上海)信息咨询有限公司东北证券股份有限公司、圆信永丰基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、上海德汇集团有限公司等 112 家机构及相关人员。
时间	2025 年 10 月 30 日 10:00-11:00
地点	线上电话会议、公司会议室。

上市公司接待人员姓名	董事、副总经理段晓婷女士 财务负责人、董事会秘书刘志波先生
投资者关系活动主要内容介绍	武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）在微纳级激光精密加工领域深耕多年，是国内首次将激光技术导入光伏太阳能电池路线的国家高新技术企业。公司深耕光伏，通过技术的开发和客户的共同研发来提升转换效率，解决行业痛点，同时也积极拓展到半导体、面板显示和消费电子领域。 公司在TOPCon、XBC等激光技术上，均有全新激光技术覆盖及订单实现；TGV激光微孔设备，公司已经完成面板级玻璃基板通孔设备的出货，实现了晶圆级和面板级TGV封装激光技术的全面覆盖；公司在超快固体激光技术应用方面有深厚的技术积累，结合PCB行业对高密度多层板的需求，公司开启了PCB行业超快激光技术的应用开发，主要方向为超快激光钻孔技术的开发，持续推动技术的延伸和应用拓展。目前，超快激光钻孔设备样机正在试制中。 一、经营方面 2025年前三季度完成营业收入17.81亿元，同比增长23.69%，归属于上市公司股东的净利润4.96亿元，同比增长29.39%，前三季度经营活动产生的现金流量净额0.11亿元，同比上升113.40%。 毛利率方面，2025年前三季度毛利率46.2%，同比下降0.79个百分点，前三季度净利润率27.85%，同比略有上升，公司毛利率一直维持相对较高的水平，体现出公司较高的技术壁垒。 2025年前三季度，公司累计研发支出1.78亿元，同比减少15.29%，占收入比重10.02%，公司在控制研发资源投入的同时，聚焦重点研发项目，确保新技术、新工艺的开发进度，维持自身的产品竞争力。 2025年9月30日，公司存货16.08亿元，公司合同负债14.13亿元，相较年初略有下降。

2025年9月30日，公司资产负债率41.57%，相较上年末的47.67%，下降了6.10个百分点，主要为合同负债和应付账款减少所致，整体而言，公司的长期偿债能力是非常稳健的，同时，2025年9月30日，公司的流动比率和速动比率分别为3.17和2.28，较近两年进一步提升，公司短期偿债能力在持续增强。

二、投资者互动主要内容

1.公司业务布局？

答：公司专注光伏多年，在光伏各种工艺路线上，都有深厚的技术储备，公司会持续推动新的激光技术在光伏行业的应用，同时为提高抗风险能力，扩大产品版图，在非光伏领域也进行了新技术的研发，包括在PCB、TGV、显示面板、集成电路等领域的投入。

2.公司PCB业务布局、进展。

答：PCB市场应用空间广阔，公司在超快固体激光技术应用方面有深厚的技术积累，基于前期在MWT电池打孔技术的应用、TGV微孔技术的持续研发，结合PCB行业对高密度多层板的需求，公司开启了PCB行业超快激光技术的应用开发，主要方向为超快激光钻孔技术的开发，持续推动技术的延伸和应用拓展。公司已与2到3家客户进行对接，目前，超快激光钻孔设备样机正在试制中。

3.展望BC2026年市场趋势。

答：预计未来几年BC产能将持续增长，短期新增产能受行业政策等多方因素影响，预计2026年BC预计有40-50GW的改扩产需求。

4.公司的激光焊接设备在客户端验证进展。

答：公司激光焊接方案上有2条路线，一是针对BC组件的全新激光焊接，已实现了中试订单，验证情况良好。期待今年四季度取得GW级量产订单的突破。二是非BC工艺上的应用，已在不同客户端验证。

5.TOPCon+上的公司TCP和TCI两款设备效率提升情况。

	答：公司 TCP 和 TCI 的单道设备效率提升大概有 0.15%-0.2%。 6.2025年Q3毛利率下滑原因。 答：主要系验收产品结构比重变化所致，当季在TOPCon领域验收的设备较多，而TOPCon订单的价值量有一定的下降，因此对整体毛利影响有所影响。 7.公司光学部件供应链情况。 答：公司与全球顶尖激光源厂商保持紧密合作，合作多年，互信良好，供应稳定，外部环境变化未影响商务合作，同时与国内激光源公司保持紧密合作以应对贸易风险带来的不确定性。 8.关于TGV设备，今年整体订单情况如何？ 答：2025年TGV有新增订单，并实现海外订单，年底前设备将进入国内大厂验证，市场以中试线为主。TGV技术经过多年研发，目前重点聚焦两个应用方向：一是在显示面板领域的应用，比如折叠屏，二是芯片先进封装领域的应用。 9.激光器占公司不同产品成本的比重。 答：公司不同激光设备中激光器占成本比重不尽相同，比重大概是30%-50%之间。 公司交流人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。
附件清单 (如有)	无。
日期	2025 年 10 月 30 日